

产品承认书


客户名称: _____

产品名称: 贴片电阻

产品规格: HoYH0805-1/2W-2mR-1%

产品编码: HoT00598

文件制作: 2025-12-22

本公司核准签章			
制作	审核	批准	
曾章垚	黄永康	冷文义	

客户确认签章			
承认	审核	批准	承认印章

■ 目的

通过本承认书对样品特性和检验标准的描述，更好的与客户沟通，与客户达成一致意见，避免因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。

■ 适用范围

本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供的样品，适用于产品的特性及产品的检验标准。

■ 订单关联

客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认，本承认书于客户收到日起两周后默认生效。

■ 产品特点

1. 合金芯片
2. 封体工艺
3. 焊接性能良好
4. 高可靠性，高过载能力，产品精度高
5. 使用温度范围较宽无感型设计
6. 符合ROHS要求和无卤要求

■ 产品应用范围

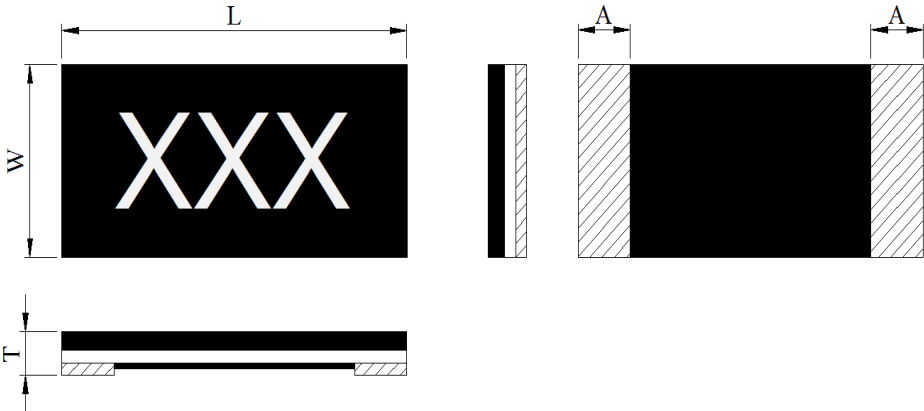
1. 电源模块
2. 工业仪器设备
3. 自动化控制系统
4. 变频驱动
5. 伺服驱动系统



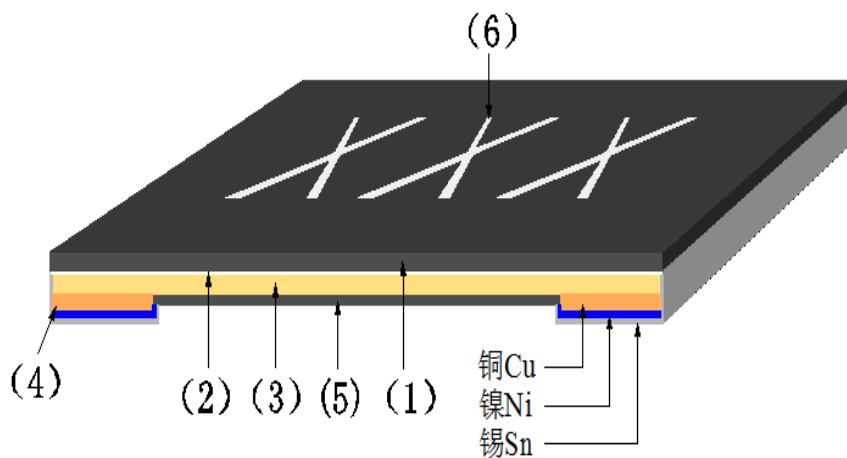
选型示例: HoYH0805-1/2W-2mR-1%
贴片电阻

<u>Ho</u>	<u>YH</u>	<u>0805</u>	<u>1/2W</u>	<u>2mR</u>	<u>1%</u>
↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	封装	功率	阻值	精度
Ho毫欧电子	YH	0805	1/2W	2mR	1%

产品尺寸

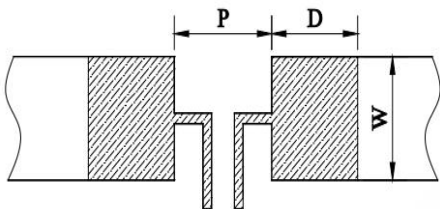
项目	参数		
尺寸(mm)	W (1.25±0.25)	L (2.0±0.25)	T (0.4±0.2)
	A (0.6±0.2)		
产品编码: HoT00598 深圳市毫欧电子有限公司 受控文件			
额定功率	1/2W		
最大额定电流	15.81A		
温漂	±75ppm		
阻值	2mΩ		
工作温度范围	-55°C~+170°C		
客户确认	客户签名:		签名时间:
备注			

产品结构及使用材料说明

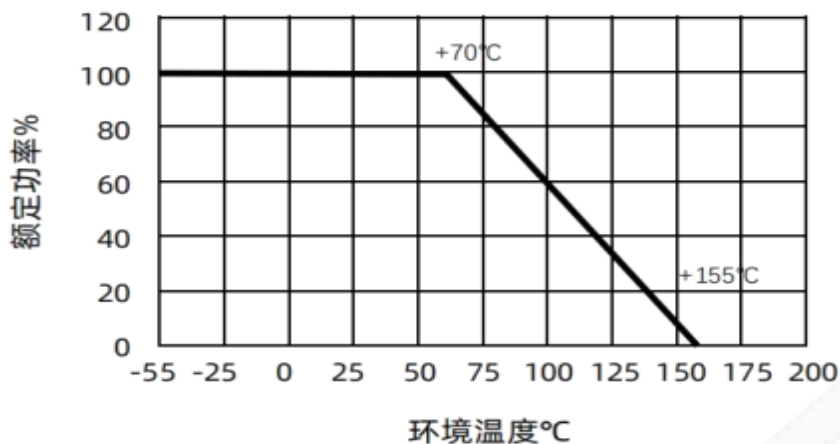


基板(1): 環氧樹脂	粘著膠層(2):環氧樹脂	電阻本體 (3): 銅合金	端電極(4): 錫、鎳、銅
保護防焊層(5): 防火級環氧樹脂,符合UL-94-V0 要求(绿色)			
文印防焊層(6): 防火級環氧樹脂,符合UL-94-V0 要求(白色)			

建议焊盘尺寸 (单位: mm)



阻值	P	W	D
2mR	0.5	1.44	1.55

功率曲线


操作温度范围-55~+155°C电阻温度达到70°C时降功率示意图

■ 可靠性测试

测试方法	条件	允收标准
瞬间过载测试	$P = 2.5P_r$; $T = 25 \pm 2^\circ\text{C}$, $t = 5\text{sec.}$	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.13
高温测试	$T = +155 \pm 2^\circ\text{C}$; $t = 1000\text{h}$	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.25
低温测试	$T = -55 \pm 2^\circ\text{C}$; $t = 1000\text{h}$	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.25
湿度负载寿命测试 (60°C、95%RH)	$V_{\text{test}} = V_{\text{max}}$; $T = 60 \pm 2^\circ\text{C}$; $\text{RH} = 95\%$; $t = 90\text{min ON, 30min OFF, 1000h}$	$\pm(2.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.25
冷热冲击测试	$[-55^\circ\text{C } 30\text{min.} \rightarrow \text{R.T. } 3\text{min.} \rightarrow +155^\circ\text{C } 30\text{min.} \rightarrow \text{R.T. } 3\text{min.}]$, 100 个连续循环 / 100Cycles	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.19
在 70°C 下负载寿命测试	$V_{\text{test}} = V_{\text{max}}$; $T = 70 \pm 2^\circ\text{C}$; $t = 90\text{min ON, 30min OFF, 1000h}$	$\pm(2\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.25
可焊性测试	浸入锡炉 / Dip into solder at $T = 245 \pm 5^\circ\text{C}$, $t = 3 \pm 0.5\text{sec.}$	锡涵盖面积 / The covered area >95% IEC60115-1 4.17
抗焊热性测试 / Resistance to Solder Heat	经热风式回焊炉 / 回流焊接过程中, 元件需经历3次回焊焊接循环。	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.18
机械热冲击测试	加速度 $a = 100\text{G}$, 振幅时间 $t = 6\text{ms}$, $a = 100\text{G}$, $t = 6\text{ms}$	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.21
基板弯曲测试	两支撑点间距 / Span between fulcrums : 90mm ; 振幅 / Bend Width: 2mm ; 测试板 / Test board: 玻璃纤维板 / Glass- Epoxy Board ; 厚度 / Thickness =1.6mm	$\pm(1.0\%+0.5\text{m}\Omega)$ IEC60115-1 4.33

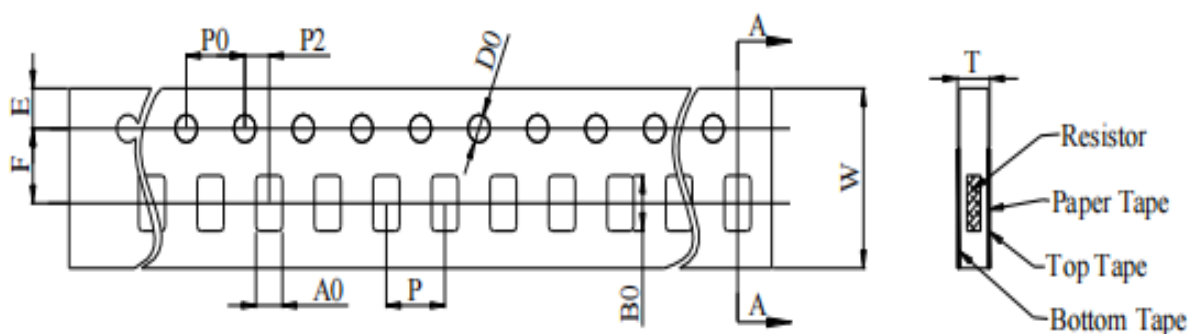
额定电流计算公式

$$I = \sqrt{P/R}$$

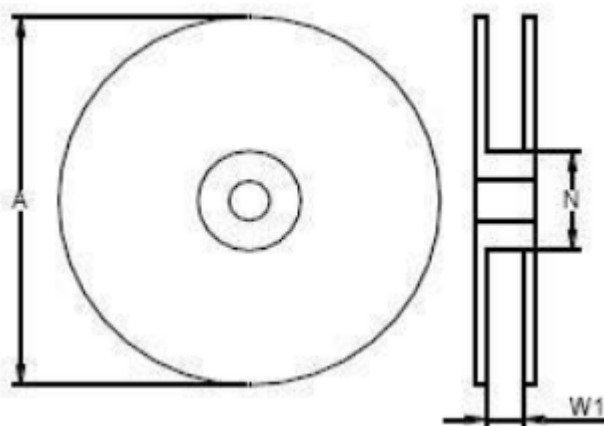
I
额定电流(A)

P
额定功率(W)

R
电阻值(Ω)

载带尺寸


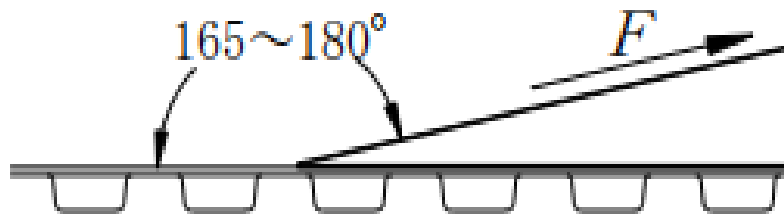
W	A0	E	P0	B0	T	P	D0	P2	F
8.0±0.3	1.55±0.1	1.75±0.1	4.0±0.1	2.3±0.1	0.75±0.1	4±0.1	1.5±0.1	2±0.1	3.5±0.1

卷轴规格


φA	N	W1	编带盘装
178±5	60±2	9.0±1	5000pcs/盘

上带的剥离强度

$F = \text{剥离强度: } 0.1 - 1.0\text{N} (10 - 100\text{gf})$



■ 产品包装及使用说明:

1、产品包装

编带盘装：5000PCS/盘；

2、产品使用说明

- ① 产品使用过程中，注意表面防护、防止产品表面出现碰伤、划伤等缺陷。
- ② 产品安装使用时，避免产品受到机械应力的影响。
- ③ 产品的长期使用功率应小于或者等于额定功率，避免长期使用过载引起的阻值漂移。
- ④ 当在高温或散热不佳的条件下使用产品时，应参考降功耗曲线进行降额应用。

3、产品存储说明

- ① 在温度+10℃~40℃、相对湿度 75%的密闭条件下可存放2年。
- ② 在温度+10℃~60℃、相对湿度为95%的非露天下最多可存放30天。
- ③ 产品需存放在干净干燥、无有害气体的环境下。
- ④ 产品未使用前，需避免将产品从编带包装中取出。